

中国国际金融股份有限公司

关于兆易创新科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）2020 年非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，现就兆易创新募集资金截至 2025 年 12 月 31 日止的存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承销商中金公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，应募集资金总额 432,402.35 万元。扣除券商的承销费用（不含增值税）3,958.49 万元后，公司此次实际收到募集金额为人民币 428,443.86 万元，上述募集资金已由主承销商中金公司于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

单位：人民币万元

发行名称	2020年向特定对象非公开发行股票
募集资金到账时间	2020年5月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	432,402.35
减：发行有关费用	3,958.49
二、募集资金净额	428,443.86
减：	
以前年度已使用金额	179,420.19
本年度使用金额	43,798.20
暂时补流金额	170,000.00
加：	
募集资金利息收入和手续费累计净额	43,082.07
截至2025年12月31日募集资金余额	78,307.54

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际制定《兆易创新科技集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据上述相关法律法规及《管理制度》的规定，公司、保荐机构与江苏银行股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于2020年6月4日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海格易电子有限公司（以下简称“上海格易”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司上海张江支行于2022年6月9日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）于2024年9月25日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司珠海横琴芯存、公司全资孙公司北京芯存集成电路有限公司（以

下简称“北京芯存”)/全资孙公司上海芯存志远半导体有限公司（以下简称“上海芯存”）/全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称“合肥芯存”）/全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）、保荐机构与宁波银行于 2024 年 9 月 25 日签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，公司、保荐机构与江苏银行股份有限公司北京分行于 2024 年 11 月 27 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海格易/全资子公司合肥格易集成电路有限公司（以下简称“合肥格易”）/全资子公司西安格易安创集成电路有限公司（以下简称“西安格易”）/全资子公司深圳市格易聚创集成电路有限公司（以下简称“深圳格易”）、保荐机构与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行于 2025 年 9 月 18 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上交所制定的协议范本不存在重大差异。

公司、上海格易、珠海横琴芯存、北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存、合肥格易、西安格易、深圳格易开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，专款专用，严格按照《管理制度》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐机构，接受保荐机构代表的监督，保证了监管协议的严格执行。

募集资金存储情况表

单位：人民币元

发行名称			2020 年向特定对象非公开发行股票	
募集资金到账时间			2020 年 5 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
兆易创新科技集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	32310188000045744	1,421,963.01	使用中
兆易创新科技集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行	32300188000128836	480,305,737.94	使用中
上海格易电子有限公司	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000469500	1,158,086.38	使用中
北京芯存集成电路有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	86011110000867955	9,780,472.00	使用中
西安芯存半导体有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	86011110000909146	36,930,945.81	使用中

上海芯存志远半导体有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	86011110000909153	9,667,216.73	使用中
珠海横琴芯存半导体有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	86011110000912124	46,222,615.61	使用中
合肥芯存半导体有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	86011110000914013	3,593,424.15	使用中
上海格易电子有限公司	招商银行北京分行清华园科技金融支行	121942339710000	56,149,977.63	使用中
合肥格易集成电路有限公司	招商银行北京分行清华园科技金融支行	551906654910000	39,151,967.49	使用中
深圳市格易聚创集成电路有限公司	招商银行北京分行清华园科技金融支行	110941316010000	38,631,125.71	使用中
西安格易安创集成电路有限公司	招商银行北京分行清华园科技金融支行	129908801210000	60,061,825.99	使用中
兆易创新科技集团股份有限公司	招商银行北京分行清华园支行	110902562710703	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

(二) 募集资金项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 1,489.77 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 1,289.65 万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金 200.12 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 010127 号）予以鉴证。

募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元

发行名称		2020 年向特定对象非公开发行股票			
募集资金到账时间		2020 年 5 月 26 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
DRAM 芯片研发及产业化项目	332,402.35	1,289.65	1,289.65	2020 年 11 月 11 日	2020 年 10 月 28 日

注：经公司于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过，公司调整“DRAM 芯片研发及产业化项目”的用途及规模，并新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。调整后“DRAM 芯片研发及产业化项目”的投资总额为 282,413.75 万元。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司、全资孙公司在募投项目的实施期间，根据实际情况先行使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金 3,152.74 万元等额置换以自有资金预先支付的款项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过 20 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。

2024 年 9 月 20 日、2024 年 11 月 26 日、2025 年 4 月 15 日，公司分别将用于暂时补充流动资金的 2.4 亿元、4.5 亿元、13.1 亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知公司保荐机构及保荐代表人。截至 2025 年 4 月 16 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 20 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限

未超过董事会授权之日起的 12 个月。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及其下属开立募集资金专户的全资子公司拟使用额度不超过 17 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 17 亿元，使用期限未超过董事会授权之日起的 12 个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：人民币万元

发行名称	2020 年向特定对象非公开发行股票				
募集资金到账时间	2020 年 5 月 26 日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
200,000	2024 年 4 月 18 日	12 个月	2024 年 4 月 18 日	2024 年 9 月 20 日	24,000
				2024 年 11 月 26 日	45,000
				2025 年 4 月 15 日	131,000
170,000	2025 年 4 月 24 日	12 个月	2025 年 4 月 24 日	2026 年 1 月 9 日	80,000
				2026 年 3 月 26 日	90,000

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司及其下属开立募集资金专户的全资子公司拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		2020 年向特定对象非公开发行股票		
募集资金到账时间		2020 年 5 月 26 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 50,000 万元	安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月	2025 年 4 月 24 日	2026 年 4 月 23 日	2025 年 4 月 24 日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或者非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子

公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司上海格易作为“DRAM 芯片研发及产业化项目”的实施主体，并使用募集资金 40,000.00 万元向其增资，对应增加实施地点上海市。本次增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用募集资金增资，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，能有效整合公司研发资源，充分利用上海市在营商环境、高校人才等方面的有利条件，提高募集资金的使用效率，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。

公司于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司珠海横琴芯存、全资孙公司北京芯存、全资孙公司上海芯存、全资孙公司合肥芯存、全资孙公司西安芯存作为“DRAM 芯片研发及产业化项目”的实施主体，并由公司使用部分募集资金 80,000.00 万元向珠海横琴芯存增资，再由珠海横琴芯存使用募集资金向北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存分别增资 1,000 万元、1,000 万元、2,000 万元、5,000 万元以实施募投项目，对应增加实施地点珠海市、北京市朝阳区、合肥市、西安市。本次增加 DRAM 募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金增资系公司对项目实施进度、内部管理架构等进行综合分析后的决定，不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高公司整体经营管理水平。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加全资子公司西安格易、全资子公司上海格易、全资子公司合肥格易、全资子公司深圳格易作为“汽车电子芯片研发及产业化项目”的实施主体，并使用部分募集资金向西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易分别增资 6,000 万元、6,000 万元、4,000 万元、4,000 万元以实施募投项目，对应增加实施地点西安市、上海市、合肥市、深圳市。本次增加“汽车电子芯片研发及产业化项目”实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资系公司对项目实施进度、内部管理架构等进行综合分析后的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和投资方向的情形，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营和未来长

远发展的规划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整“DRAM 芯片研发及产业化项目”用途及规模，将项目总投资金额由 399,173.60 万元减少至 357,018.51 万元，拟投入募集资金金额由 332,402.35 万元减少至 282,413.75 万元，项目的预定可使用状态日期由 2026 年 5 月调整至 2028 年 12 月；同意公司使用募集资金 70,644.12 万元投入新增募投项目“汽车电子芯片研发及产业化项目”；同意公司将 20,216.50 万元募集资金用于永久补充流动资金，具体金额将以股东会审议通过该事项后实际补充流动资金时募集资金余额扣除尚待投入 DRAM 芯片研发及产业化项目及汽车电子芯片研发及产业化项目后的余额为准（实际用于永久补充流动资金的金额为 20,539.92 万元）。

五、保荐机构结论性意见

兆易创新募集资金 2025 年度存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金 2025 年度具体使用情况与公司已披露情况一致。中金公司对公司董事会披露的募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称			2020 年向特定对象非公开发行股票										
募集资金到账日期			2020 年 5 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			43,798.20										
已累计投入募集资金总额			223,218.39										
变更用途的募集资金总额			91,184.04										
变更用途的募集资金总额比例			21.28%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
DRAM 芯片研发及产业化项目	研发项目	部分变更	332,402.35	282,413.75	282,413.75	39,459.51	102,289.45	-180,124.30	36.22	2028 年 12 月	38,150.98	建设期	否
汽车电子芯片研发及产业化项目	研发项目	是		70,644.12	70,644.12	4,338.69	4,338.69	-66,305.43	6.14	2028 年 12 月	建设期	建设期	否
补充流动资金 1	补流	否	96,041.51	96,041.51	96,041.51	/	96,050.33	8.82	100.01	不适用	不适用	不适	否

												用	
补充流动资金 2	补流	是		20,539.92	20,539.92	/	20,539.92	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			428,443.86	469,639.30	469,639.30	43,798.20	223,218.39	-246,420.90	47.53		38,150.98		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2025 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金项目先期投入及置换情况”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。												

注 1：上述数据保留两位小数，数据如有尾差，均为四舍五入所致。

注 2：调整后投资总额较募集资金承诺投资总额的差额为募集资金利息收入再投入。

注 3：“DRAM 芯片研发及产业化项目”，因研发所需高端设备交货周期长，设备投入与募集资金的支付存在时间性差异，此外 2025 年实现研发技术突破，有效节约了当年设备投入成本。未来三年，公司多个研发项目将逐步进入流片关键节点，同时更新代际存储芯片将展开研发，相关研发项目涵盖流片验证、高端设备采购、核心研发团队扩充等多项大额资本性支出，募集资金投入力度会随之提升。

注 4：“汽车电子芯片研发及产业化项目”因研发难度较大，公司为审慎使用募集资金，项目初期主要由自有资金支持。经过前期的技术攻关与经验积淀，研发团队专业能力及项目推进效率未来预期会实现稳步提升，2026 年至 2028 年公司拟分批启动多类车规项目研发，相关项目采用更高阶的制造工艺，设备采购、技术研发等资本性支出及人工投入规模预计将大幅增加。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

发行名称		2020 年向特定对象非公开发行股票													
募集资金到账日期		2020 年 5 月 26 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
DRAM 芯片研发及产业化项目	DRAM 芯片研发及产业化项目	研发项目	兆易创新、上海格易、珠海横琴、北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存	北京市海淀区、上海市、珠海市、北京市朝阳区、合肥	282,413.75	282,413.75	39,459.51	102,289.45	36.22	2028 年 12 月	38,150.98	建设期	否	2024 年 11 月 5 日	2024 年 11 月 26 日

				市、西安市											
汽车电子芯片研发及产业化项目	DRAM 芯片研发及产业化项目	研发项目	兆易创新、西安格易、上海格易、合肥格易、深圳格易	北京市、西安市、上海市、合肥市、深圳市	70,644.12	70,644.12	4,338.69	4,338.69	6.14	2028年12月	建设期	建设期	否	2024年11月5日	2024年11月26日
补充流动资金2	DRAM 芯片研发及产业化项目	补充	兆易创新	北京市	20,539.92	20,539.92		20,539.92	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	2024年11月5日	2024年11月26日
合计					373,597.79	373,597.79	43,798.20	127,168.06	—	—	38,150.98	—	—	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			公司于2024年11月5日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整“DRAM 芯片研发及产业化项目”用途及规模，将项目总投资金额由 399,173.60 万元减少至 357,018.51 万元，拟投入募集资金金额由 332,402.35 万元减少至 282,413.75 万元；同意公司使用募集资金 70,644.12 万元投入新增募投项目“汽车电子芯片研发及												

	<p>产业化项目”；同意公司将 20,216.50 万元募集资金用于永久补充流动资金，具体金额将以股东会审议通过后实际补充流动资金时募集资金余额扣除尚待投入 DRAM 芯片研发及产业化项目及汽车电子芯片研发及产业化项目后的余额为准。</p> <p>变更原因：</p> <p>1.调整募投项目：DRAM 芯片研发及产业化项目</p> <p>根据 DRAM 产品市场需求变化、产品技术迭代变化、公司产品战略等因素，公司将募投项目 DRAM 芯片研发及产业化项目的用途从原有项目开发四种产品 DDR3、DDR4、LPDDR3 和 LPDDR4 调整为 DDR3、DDR4、LPDDR4 和 LPDDR5，该项目的预定可使用状态日期由 2026 年 5 月调整为 2028 年 12 月。由于项目所需设备的国产化率有所提升等原因，设备购置费有所下降，项目总投资金额由 399,173.60 万元减少至 357,018.51 万元，拟投入募集资金金额由 332,402.35 万元减少至 282,413.75 万元。</p> <p>公司针对“DRAM 芯片研发及产业化项目”进行调整，主要系基于 DRAM 产品市场需求变化、产品技术迭代变化、公司产品战略等因素进行的调整。受公共卫生事件等外部原因的影响，公司在实施募投项目过程中相对谨慎，为有效控制风险，因此未正式启动开发 LPDDR3 产品且暂未使用募集资金。公司根据对产品市场周期的最新研判，目前 LPDDR3 产品在小容量市场或将面临市场收缩，该产品量产后可能面临市场空间不足的局面，而 LPDDR5 产品预计将在 2029 年或 2030 年进入小容量产品市场，能够与公司募投项目周期相匹配，有助于公司未来发展。因此从长远发展的考虑上，公司对原有项目进行产品规划调整，并相应调整募集资金投入金额。</p> <p>2.新增募投项目：汽车电子芯片研发及产业化项目</p> <p>基于国家大力发展汽车芯片、提升汽车芯片国产化率的相关战略和政策指引，以及对车规级 MCU 芯片国产替代市场的空间的判断，公司结合在汽车电子芯片领域的战略规划和业务布局，将募集资金 70,644.12 万元，用于汽车电子芯片研发及产业化募投项目，以提高公司高端 MCU 产品研发能力，进一步丰富产品线，抓住汽车 MCU 市场国产替代发展机遇，进一步扩展市场空间，增强公司竞争力。</p> <p>3.部分募集资金永久补充流动资金</p> <p>为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，降低财务成本，并为公司日常生产经营及业务发展提供资金支持，公司将 20,539.92 万元募集资金永久补充流动资金。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>不适用</p>

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

注 1：上述数据保留两位小数，数据如有尾差，均为四舍五入所致。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于兆易创新科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

王琨

王 琨

杨智博

杨智博



中国国际金融股份有限公司

2026年3月30日